

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	浙商证券、杭州久盈、立元集团等多家机构
时间	2024年09月20日 13:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 赵奇 财务负责人、董事会秘书 王伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>现场交流与问答：</p> <p>问题 1：公司上半年整体的运营状况，产能利用率情况如何？</p> <p>回复：2024年上半年，公司实现营业收入为 28.80 亿元，同比增长 14.27%；实现归属于母公司所有者的净利润为-4.71 亿元，与上年同期相比减亏 6.38 亿元、同比减亏 57.53%。</p> <p>受益于新能源及消费市场的旺盛需求，上半年，公司车载及消费领域营收占公司主营收入超 80%，其中车载领域营收环比增加 3.08 亿元，增幅超 30%；消费领域营收环比增加 2.57 亿元，增长 37%，同比增幅达 107%。</p> <p>随着市场需求的复苏，伴随芯片国产化的大趋势，公司 8 英寸硅基产品线产能利用率饱满；SiC 晶圆产线、12 英寸硅基晶圆产线及对应的模组产线产能及产能利用率显著提升。</p> <p>① SiC 晶圆产线：收入同比翻三番，环比增幅超 50%</p> <p>上半年公司碳化硅业务继续保持先发优势，应用于汽车主驱的车规级 SiC MOSFET 产品出货量亚洲第一。在产线建设方面，公司 8 英寸碳化硅产线于 2024</p>

年4月完成工程批下线，实现中国第一，全球第二通线。报告期内，公司SiC MOSFET晶圆产品收入比上年同期增长超300%、环比增长超50%。2024年，公司碳化硅产品预计实现10亿元以上收入。

② 12英寸硅基晶圆产线：提前完成产能建设，收入同比增长超7倍。

2024年上半年，公司完成了12英寸硅基晶圆产线3万片的产能建设，并实现产能阶梯式爬升。报告期内，公司12英寸硅基晶圆收入比上年同期增长达786%。在模拟IC产品方面，公司也立足于车规级BCD平台，是国内在该领域布局最完整的企业之一。公司的BCD工艺技术研发已达到国际领先水平。今年上半年，公司相继推出数模混合嵌入式控制芯片制造平台、高边智能开关芯片制造平台、高压BCD 120V平台，SOI BCD平台等多个车规级技术平台。

公司应用于AI服务器多相电源的0.18um BCD工艺产品成功量产，特别是公司面向数据中心服务器的55nm高效率电源管理芯片平台技术已获得客户重大项目定点。

③ 模组产线：客户黏性提升效果明显，功率模组装车量同比快速增长

公司拥有完整的功率模块系列制造能力，产品广泛应用于新能源汽车、智能电网、光伏风电储能、智能家电等领域，今年上半年，公司的车载功率模块产品获得欧洲知名车企定点采购，以及多家海外知名Tier1的批量导入，市场占有率不断攀升。根据NE时代发布的2024年上半年中国乘用车功率模块装机量，芯联集成功率模块装机量已超59万套，增速同比超5倍，市场占有率接近10%。

问题2：此次并购芯联越州是基于怎样的考虑呢？未来业务整合协同？

回复：本次交易有利于上市公司获取主营业务所需的关键技术，并加速产品迭代。标的公司除布局一条月产7万片8英寸硅基晶圆生产线外，还前瞻性战略布局了SiC MOSFET、VCSEL和高压模拟IC等业务。

(1) 8英寸硅基晶圆形成规模效应，有利于降低成本，提升盈利能力

本次交易完成后，公司已有的月产10万片8英寸硅基晶圆生产线将与芯联越州的月产7万片8英寸硅基晶圆生产线合并，进行一体化管理，总产能达到月产17万片。一体化管理后，在采购管理方面，上市公司可将标的公司目前相对独立的采购部门纳入统一管理，发挥采购规模效应，提升议价能力；在库存管理方面，上市公司可整体降低原材料等采购备货，降低库存成本；在资

金方面，可实现资金统一调配，减少单体流动资金储备。

(2) SiC MOSFET 形成协同效应，有利于公司加速将 SiC MOSFET 培育成为重要的盈利来源之一

2023 年度及 2024 年上半年，标的公司应用于车载主驱的 6 英寸 SiC MOSFET 出货量均为国内第一，产品核心技术参数比肩国际龙头水平；2024 年 4 月，标的公司 8 英寸 SiC MOSFET 工程批顺利下线。而上市公司的车规产品已覆盖绝大部分新能源汽车终端客户，工控产品覆盖主要风光储新能源终端客户。本次交易完成后，上市公司在 SiC MOSFET 产品上将形成协同效应。上市公司将集中资金优势、技术优势、采购优势和客户优势，全方位投入资源以更好地助力碳化硅业务的快速发展，加快推动国内首条 8 英寸 SiC MOSFET 生产线建设，争取在 2025 年内提早实现量产，成为国内首家实现规模量产的 8 英寸 SiC MOSFET 企业，并使其成为公司未来重要的盈利来源之一。

问题 3：接下来公司会如何规划产线布局来增强竞争力？市场策略是怎样？

回复：公司已经布局了三条核心增长曲线，覆盖不同的产品领域和应用方向。各增长曲线的循环协同效应和相互促进效果，保障了公司未来在营收上的持续稳定增长。

以 IGBT、MOSFET、MEMS 为主的 8 英寸硅基芯片及模组产线为公司第一增长曲线。2024 年上半年，伴随去库存逐步完成，叠加 AI 大模型赋能智能手机和 AI PC 加速迭代升级，消费电子需求回暖，带动公司消费领域产品的需求增加，产能利用率持续提升。

SiC MOSFET 芯片及模组产线为公司第二增长曲线。SiC MOSFET 产品定点项目陆续批量投产，带动产线持续保持满产。公司目前 SiC 技术储备丰富，不断导入国内外头部客户，帮助公司向未来占据全球 30% 市场份额的目标稳步前进。

以高压、大功率 BCD 工艺为主的模拟 IC 方向是公司的第三增长曲线。上半年发布了多个集成化的 BCD 工艺平台，填补了国内空白，并携手芯片设计合作伙伴获得国内多个车企和 Tier1 项目定点，帮助车企客户和 Tier1 提高系统的可靠性、降低成本，从而提升市场竞争力。公司高质量的车规产品生产管理体系，也获得全球知名 Tier1 车规级最高等级 A 级认证。

公司将继续坚持技术+市场双轮驱动的策略，推动三条增长曲线共同成长。公司将在已经具备领先优势的产品线 MEMS、IGBT、SiC MOSFET、BCD、VSCEL、

功率模组等方面，持续进行市场的开拓和技术的迭代，实现技术赶超，扩大市场份额，并积极进入海外市场；进一步重点发展高压模拟集成芯片新工艺技术平台，为广大产品公司打造有竞争力的国产模拟集成芯片提供最优质的代工制造平台。同时，公司还将不断拓展新产品线，计划于下半年推出高可靠性、高性能专用 MCU 平台；也将不断拓宽业务领域，全面布局高增长的 AI 高速服务器领域，为 AI 服务器电源，AI 集群通信等多个 AI 系统提供完整的电源管理芯片和模组的代工服务，为产品公司打造国内 AI 服务器电源代工方案提供技术支撑和大规模高质量交付保障。多个产品的长期项目定点，叠加多个新技术平台、新产品以及新客户的导入，为公司进入新的高速增长期提供了强大的动力和信心。

问题 4：创新是半导体行业新一轮增长的关键，目前公司的技术方向和研发推进及落地量产情况如何？

回复：2024 年，公司继续加大研发投入，上半年，公司合计研发投入 8.69 亿元，比上年同期增长 33.75%。与此同时，公司加强引进高端技术人才，不断进行技术迭代，在功率、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向持续取得重大突破，市场应用领域不断拓展。

（1）汽车电子方面：

功率器件特别是先进 SiC 芯片及模块进入规模量产，工艺平台实现了 650V 到 1700V 系列的全面布局，掌握核心先进制造工艺，产品关键指标均处于对齐国际先进的水平，大范围获得国内外主流车厂和 Tier1 的定点，8 英寸 SiC 的器件和产品验证进度超预期，这些都为公司未来的快速增长铺平了道路。公司推出的新一代 IGBT 产品，关键性能指标业界领先，较高的性价比正在帮助公司进一步扩大市场占有率。

模拟 IC 芯片领域，公司聚焦于国内稀缺的高性能、高功率、高可靠性 BCD 技术方向。上半年公司新发布四个车规级平台，其中数模混合嵌入式控制芯片制造平台填补了国内驱动+控制集成化芯片技术的空白；高边智能开关芯片制造平台、高压 BCD 120V 平台对应的技术为国内该领域的稀缺技术；高压 SOI BCD 平台对应的技术位于国内领先水平。同时，公司携手多个芯片设计客户，获得国内多个车企和 Tier1 项目定点。

（2）工业控制方面：

AI 服务器、数据中心等应用方向：上半年用于数据中心光模块的硅光产品进入量产；发布了第二代高效率数据中心专用电源管理芯片制造平台，获得关键客户的产品导入。

	<p>智能电网方向：4500V 超高压 IGBT 产品已在国家电网试点挂网验证通过，进入大范围推广和大规模量产阶段。大功率地面站光伏、风电和储能应用方向：持续推出新一代高性能、高可靠性先进产品并完成验证，将在下半年陆续进入大规模量产。</p> <p>(3) 消费电子方面：</p> <p>手机以及可穿戴应用领域：公司的 MEMS 传感器和锂电池保护芯片产品已经占据市场和技术领先位置，在出货量和市场份额上均获得新一轮增长。应用于高端手机的高性能麦克风（信噪比>70dB）和惯性传感器（IMU）进入量产。公司推出的面向手机锂电池保护的新一代制造平台，持续保持业界领先地位。</p> <p>家电应用领域：公司推出全系列智能功率模块（IPM）产品，已成功切入市场，并持续扩大终端应用范围，有望继续提升市场占有率。</p> <p>目前，公司已拥有一支有深厚技术积累的研发团队，团队核心均为深耕于行业几十年的研发技术人员，其专业能力和创新思维为公司的技术研发提供了保障。在创新能力方面，公司每年进入一个新的技术和产品领域，不断研发出新技术、新产品，推动公司技术的进步和产品的升级迭代。公司建立了科学高效的研发管理体系，通过流程化和项目管理缩短了研发周期。公司建立六年多以来，已获得 364 项知识产权，其中发明专利 175 项，实用新型专利 182 项。同时已实现将研发成果快速转化为实际产品和服务的能力，技术转化率在行业内处于领先地位。</p> <p>问题 5：下半年预计公司整体增长如何？</p> <p>展望下半年，公司认为新能源汽车、消费、风光储三大市场将呈现出以下发展趋势：一是中国新能源汽车整体市场仍在增长，8 月新能源乘用车月销超百万辆，渗透率连续 2 个月突破 50%，随着对燃油车排放标准的限制将进一步推动新能源车的市场份额提升；二是消费电子行业景气度上行，AI 技术的陆续落地，多家手机厂商新品亮相，有望为公司带来新的增长点；三是新能源风光储市场已逐渐触底恢复，并且随着政策的持续加码和有效需求的逐步释放，新能源风光储市场将进一步扩大。得益于国内市场增长和国产替代的双重驱动，整体市场需求有望持续向好，公司预计今年第三季度的收入将继续保持两位数增长。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024年09月20日
----	-------------